

EE-SX1330-2

微型光电传感器(透过型)

欧姆龙超小型槽型·SMD型(槽宽: 3mm)

- 响应时间缩短至以往产品一半以下的高速响应型
- 有助于在各种用途中实现高速响应和低功耗



请参阅第3页的“请正确使用”。



型号结构

EE-SX □ □ □ 0-2
① ② ③ ④

①检测方式

X: 透过型

②输出形态

1: 光电晶体管输出

③连接方式

3: 表面封装型

④检测距离

3: 3mm

种类

(交货期请向经销商咨询。)

本体

形状	检测方式	连接方式	检测距离	狭缝尺寸 纵×横(mm)	输出形式	型号	最低发货数量
	透过型 (槽型)	表面 封装型	3mm(槽宽)	发光侧 1.4×1.4 受光侧 1×0.3	光电晶体管	EE-SX1330-2	1,000

额定值/性能/外装规格

绝对最大额定值($T_a=25^\circ\text{C}$)

项目	额定值	单位
发光侧	25 ^{*1}	mA
	100 ^{*2}	mA
	5	V
	75 ^{*1}	mW
受光侧	12	V
发射极·集电极之间电压	5	V
集电极电流	20	mA
集电极损耗	75 ^{*1}	mW
动作温度	-30~+85 ^{*1}	°C
储存温度	-40~+90 ^{*1}	°C
回流焊接温度	255 ^{*3}	°C

*1. 环境温度超过25°C时, 上表不适用。

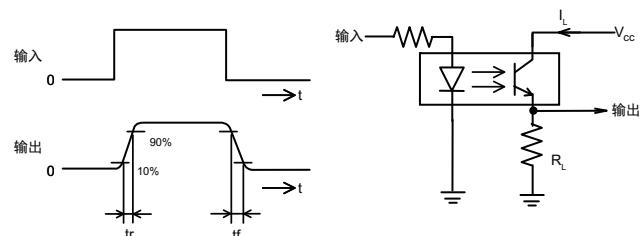
*2. 占空比1%, 脉冲宽度0.1ms

*3. 焊接时间10秒以内

电气及光学特性($T_a=25^\circ\text{C}$)

项目	特性值			单位	条件
	MIN.	TYP.	MAX.		
发光侧	正向电压	—	1.1	1.3	V $I_F=5\text{mA}$
	反向电流	—	—	10	μA $V_R=5\text{V}$
	峰值发光波长	—	940	—	nm $I_F=20\text{mA}$
受光侧	光电流	200	—	1,000	μA $I_F=5\text{mA}$, $V_{CE}=5\text{V}$
	暗电流	—	10	100	nA $V_{CE}=10\text{V}$
	集电极·发射极之间饱和电压 V_{ce}	—	0.1	0.4	V $I_F=20\text{mA}$, $I_L=100\mu\text{A}$
	峰值分光灵敏度波长	—	900	—	nm $V_{CE}=5\text{V}$
上升时间	—	7	—	μs	$V_{CC}=5\text{V}$, $R_L=100\Omega$, $I_L=500\mu\text{A}$
下降时间	—	11	—	μs	$V_{CC}=5\text{V}$, $R_L=100\Omega$, $I_L=500\mu\text{A}$

注：上升时间、下降时间的定义如下图所示。



外装规格

连接方式	重量(g)	材质
		外壳
表面封装型	0.2	PPS



咨询电话 400-820-4535 最新信息 → www.fa.omron.com.cn

特性数据(参考值)

图1. 正向电流·集电极损耗的温度额定值图

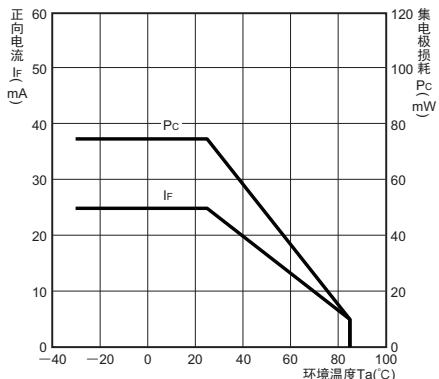


图2. 正向电流—正向电压特性(TYP.)

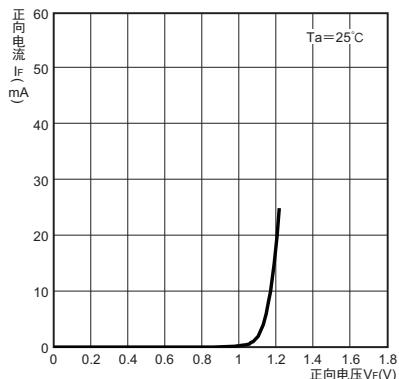


图3. 光电流—正向电流特性(TYP.)

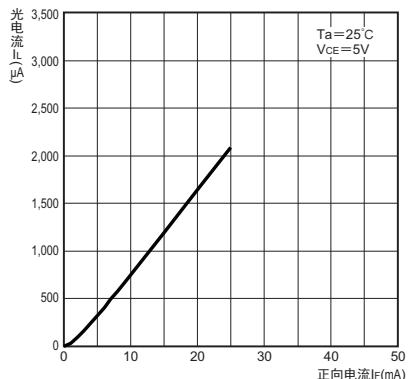


图4. 光电流—集电极·发射极之间电压特性(TYP.)

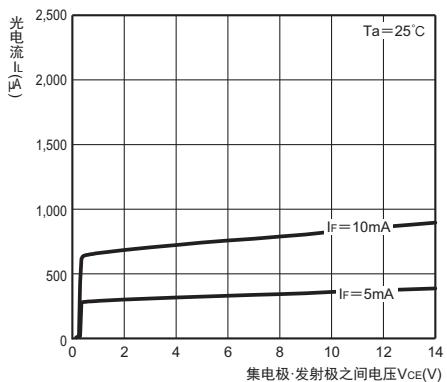


图5. 相对光电流—环境温度特性(TYP.)

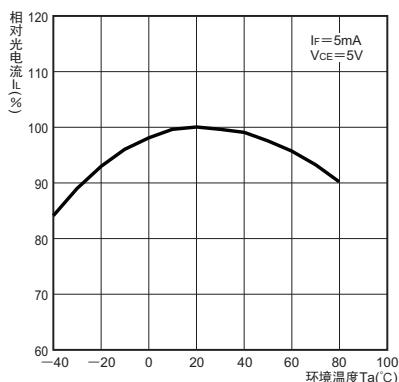


图6. 暗电流—环境温度特性(TYP.)

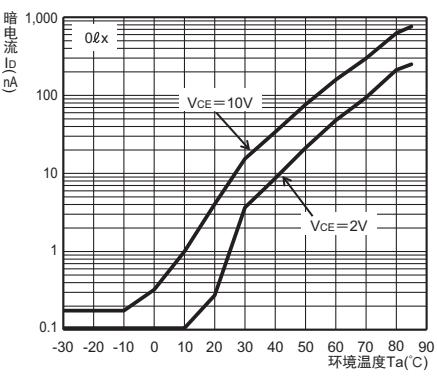


图7. 响应时间—负载电阻特性(TYP.)

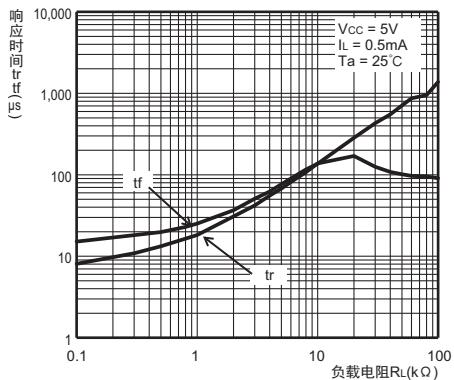


图8. 检测位置特性(TYP.)

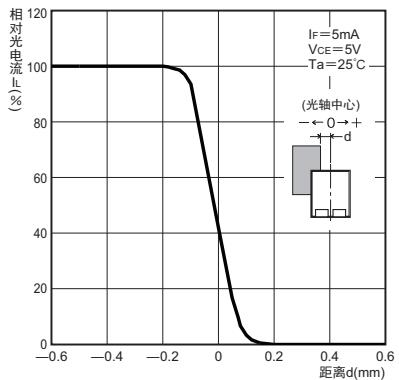
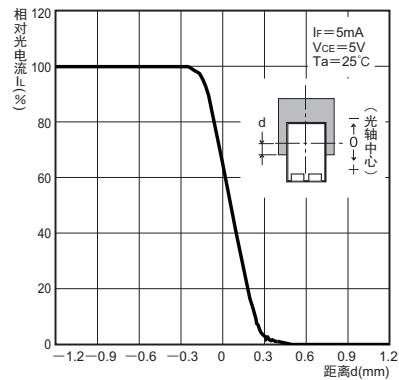


图9. 检测位置特性(TYP.)



请正确使用

详情请参阅通用的注意事项及订购时的承诺事项。

注意

本产品不能以确保安全为目的，直接或间接用于人体

检测。

请勿将本产品用作人体保护检测装置。

使用注意事项

●请勿在超过额定范围的环境中使用。

●本产品是表面封装品。请遵守封装注意事项、保存方法、烘烤条件。

●报废本产品时，请作为工业废弃物处理。

安全要点

●请勿在超出额定电压、电流范围的条件下使用。

如果施加超过额定值范围的电压或电流，可能导致产品破损或烧毁。

●请勿误接线，如混淆电压极性等。

否则可能导致产品破损或烧毁。

●本产品并非防水规格，因此请避免沾水。

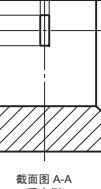
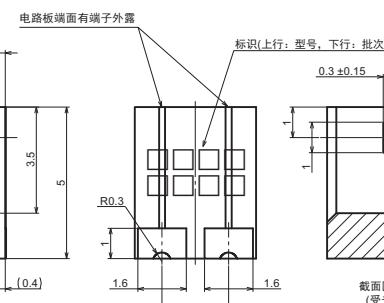
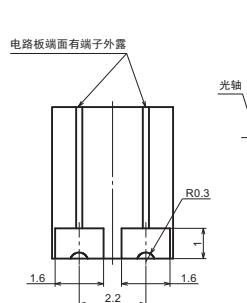
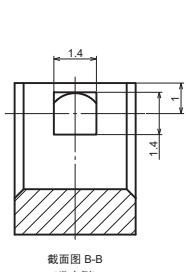
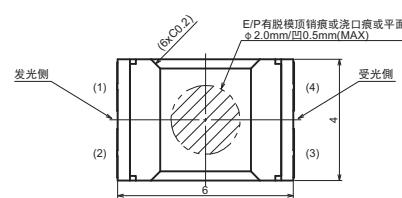
外形尺寸 / 内部电路

(单位: mm)

本体

EE-SX1330-2

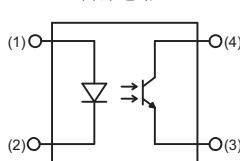
CAD数据



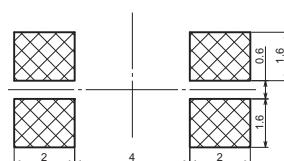
狭缝尺寸(纵×横)

发光侧	受光侧
1.4×1.4	1×0.3

内部电路



端子记号	名称
(1)	阳极端子
(2)	阴极端子
(3)	发射极
(4)	集电极



未指定的尺寸公差为±0.2。

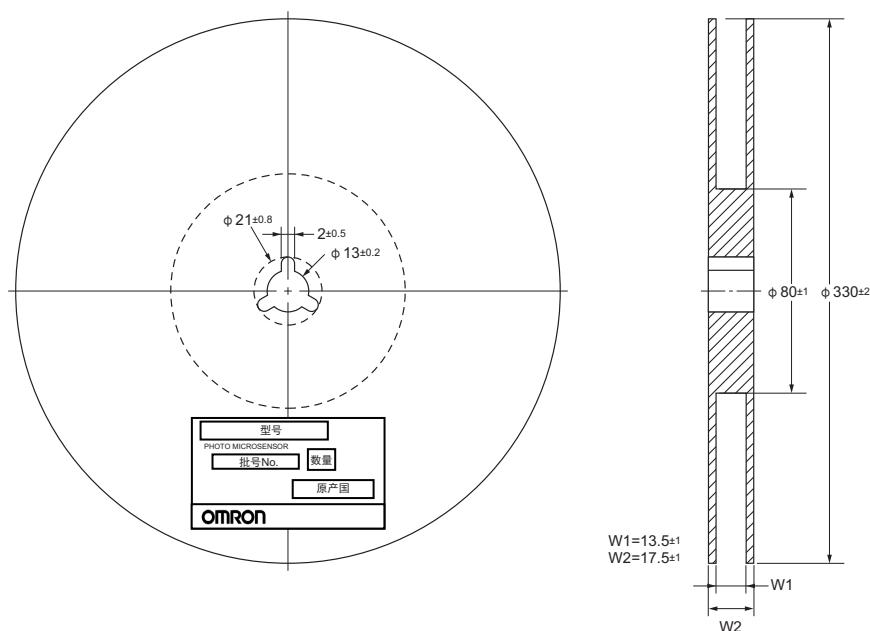


咨询电话 400-820-4535 最新信息 → www.fa.omron.com.cn

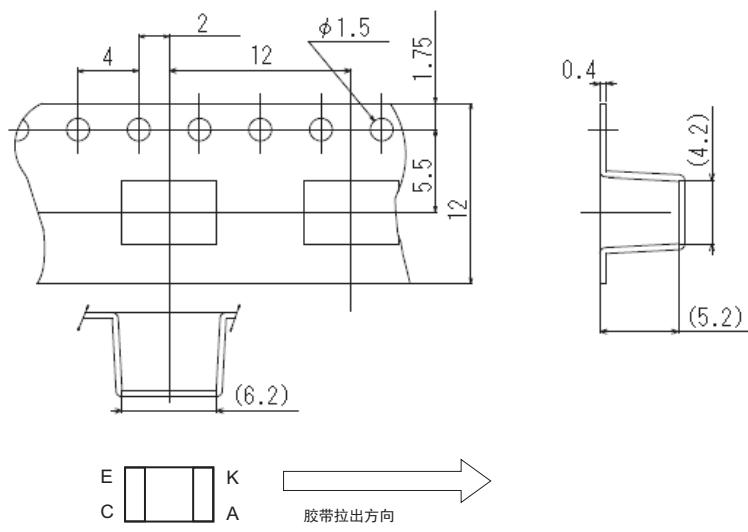
OMRON

压纹带规格

卷盘形状尺寸(单位：mm)



胶带尺寸(单位：mm)



注：包装胶带的方孔内的传感器朝向如上图所示。

数量

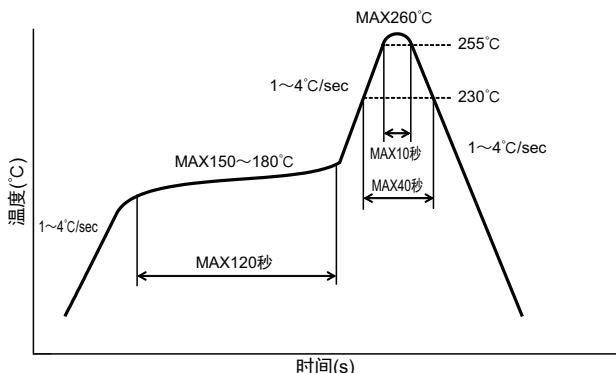
1,000个/卷



封装注意事项

● 回流焊接：温度曲线

- (1) 以下图的温度曲线以下的温度、时间最多可进行2次。
- (2) 金属掩模的厚度推荐为t=0.2~0.25mm。



● 手动焊接

无法手动焊接。否则，可能因发热导致外壳变形和电极剥落。

● 其他注意事项

焊接时的加热中使用红外灯等时，可能导致树脂部分发生局部温度上升。

使用时请将封装温度控制在上述温度曲线的条件范围内。

此外，请勿采取将树脂部分浸渍在焊锡中的方法。

即使在上述温度曲线范围内，因电路板的翘曲、弯曲等而对端子施加了应力的情况下，可能会引发封装内部的金线断线。

在本公司回流焊接装置中，请在充分确认工序条件(包括助焊剂、清洗材料、方法)后使用。

保存方法

● 保存条件

为避免产品吸湿，开封前请保存在防潮盒中，或按以下条件保存。

保存温度：10~30°C

保存湿度：60%RH以下

● 开封后的处理

(1) 开封后，请在温度10~30°C、湿度60%RH以下的条件下，在48小时内进行封装。

(2) 开封后不得不进行保存的情况下，请保存在防潮盒内，或与干燥剂一起在防湿包装内重新密封，在温度10~30°C、湿度60%RH以下的环境下保存，在1周内进行封装处理。

烘烤

防湿包装开封后经过48小时以上的产品在使用前请在下述条件下进行烘烤。

但烘烤处理最多为1次。

推荐条件: 60°C×24~48小时(卷盘状态)

100°C×8~24小时(散装状态)



咨询电话 400-820-4535 最新信息 → www.fa.omron.com.cn

OMRON

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品(中国)统辖集团

网站

欧姆龙电子部件贸易(上海)有限公司

<https://components.omron.com.cn>